

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 √其他 <u>2026 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2026 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的中小投资者及机构投资者
时间	2026 年 9 月 17 日(周四)下午 15:30~17:00
地点	公司通过全景网“全景路演”网站（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长：甘国庆 2、董事会秘书、副经理：朱焘
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 15:30~17:00 在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参加 2026 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。本次投资者网上集体接待日的主要问答情况如下： 1. 请管理层具体拆解 Q2 利润环比几乎持平的原因（长协占比、提价执行时滞、铜价成本传导），并介绍 7—8 月高端铜箔加工费的实际执行价格相比 Q2 的变化幅度；公司对 Q3 单季归母净利润能否环比加速是否具备信心，能否给出方向性指引？ 您好，感谢对公司的关注。公司铜箔业务采用“铜价+加工费”的定价模式，利润受铜价波动、加工费水平、产品结构及良率等多重因素综合影响。高端 HVLP 产品具备技术溢价，不同代际产品、不同客户之间加工费差异较大。公司正持续推进高阶产品产能释放，优化产品结构，努力提升盈利水平。 2. 据公开交流信息，公司 HVLP3/4 代产品订单已锁定至 2027 年。请问长协订单占当前高端产品出货量的比例是多少？长协合

同中是否包含价格调整条款（例如与现货加工费或铜价指数挂钩、按季度重定价、设置涨价分享机制）？公司新签长协的加工费基准相比存量长协是否已经有明确提升，提升幅度大致多少？

您好，感谢对公司的关注。公司铜箔采用“铜价+加工费”定价模式，公司生产主要采取“以销定产”的原则制定生产计划。

3. 公司 HVLP4 已实现对下游客户批量供货，HVLP5 已突破关键性能指标，但当前出货主力仍是 HVLP2 代。请介绍 HVLP4 目前的月出货量级、占 PCB 铜箔产量的比例，以及下半年的结构提升目标；HVLP5 的客户认证与量产时间表；同时请量化说明——从 HVLP2 升级到 HVLP3、HVLP4、HVLP5，单吨加工费和单吨毛利大致各能提升多少。

您好，感谢对公司的关注。请关注公司定期报告。

4. 公司高端铜箔已进入国内头部覆铜板企业供应链，并已实现出口。请问目前是否已通过海外 AI 服务器/GPU 产业链客户的料号认证，认证覆盖 HVLP 第几代产品？2026 年上半年海外收入占比是多少，下半年目标如何？在三井金属等日系厂商占据全球高端铜箔有效供给绝大部分份额的格局下，公司替代份额的推进节奏和主要障碍是什么？

您好，感谢对公司的关注。公司 HVLP1-4 代产品已通过全系列认证。2026 年上半年公司境外收入占主营业务收入 2%。当前全球 HVLP 高端铜箔市场，日系厂商凭借长期工艺沉淀、成熟供应链体系，占据较高有效供给份额，公司国产替代是循序渐进推进的过程，并非一次性替代。

5. 请问在高端 PCB 铜箔供不应求的背景下，公司的高端产能弹性主要来自哪里——老线技改、良率提升还是委外代工？现有 HVLP 产线的良率水平是多少、提升空间多大，良率提升可等效释放多少产能？公司是否考虑以合资、轻资产或分步投产的方式扩大高端供给？

您好，感谢对公司的关注。公司前瞻性布局高端铜箔赛道，已建成多条 HVLP 铜箔产线；2025 年新增购置多台表面处理机，

	进一步扩充 HVLP 铜箔产能规模。HVLP 不同代际产品良率差异较大，HVLP1/2 工艺成熟度高，良率相对稳定；HVLP4 尚处于持续爬坡阶段，还有工艺优化与良率提升空间。 6. 请问 HVLP1~4 的 2026 年总产量预计是多少？加工费在环比上涨？及池州新扩产 2 万吨 HVLP4/5 的最新进展情况？ 您好，感谢对公司的关注。目前铜箔行业景气度持续回升，高端 PCB 铜箔供不应求，实现量价齐升，上半年公司高频高速铜箔产量占 PCB 铜箔产量的比例已突破 50%。公司 HVLP1-4 系列产品已实现批量供货，HVLP 产品全年产量受产线良率、订单排产等多重因素影响，公司不做全年产量的硬性预测，相关经营数据请以定期报告为准。 7. 董秘，您好！结合 2026 半年报，公司 HVLP 系列高端 PCB 铜箔的研发迭代进展如何？HVLP4、HVLP5 代产品送样、客户验证以及批量供货情况怎样？后续高端铜箔研发立项规划，以及研发投入预算安排是怎样的？ 您好，感谢对公司的关注。公司 HVLP1-4 系列产品已实现批量供货，HVLP5 铜箔已突破关键性能指标。公司高度重视铜箔新产品领域布局，将根据市场需求、技术迭代及自身战略，稳定推进新产品研发，持续优化产能结构。 8. 业绩环比没有增长，是否有扩产的意向，从而带动环比增长，还有各大厂商都在涨价，我们是否有涨价的考虑？ 您好，感谢对公司的关注。公司业绩受铜价波动、加工费水平、产品结构及良率等多重因素综合影响，产能释放是中长期过程。公司铜箔产品订单充足，正在有序排产交货，产品价格将根据市场情况调整。 9. 请问铜冠铜箔 hvlp5 进展顺利吗？有没有进一步消息？第二批三船设备收到了吗？第一批何时可以正式加入生产线，调试完毕，量产？ 您好，感谢对公司的关注。HVLP5 铜箔已突破关键性能指标，目前正在按计划推进中。
--	---

10. 请问三季度公司高端电子铜箔产销比上一个季度有大幅增长吗？

您好，感谢对公司的关注，请关注我公司三季度报告。

11. 铜冠铜箔未来怎么紧跟 Ai 发展？

您好，感谢对公司的关注，公司将根据市场需求、技术迭代及自身战略，稳步推进新产品研发，持续优化产能结构，满足客户需求。

12. 请问锂电铜箔加工费是否已见底回升， $5\mu\text{m}/4.5\mu\text{m}$ 超薄铜箔占锂电铜箔的比例与全年目标是多少，储能订单占比如何？铜扁线等亏损业务是否有收缩、改造或剥离的安排？两块业务合计对公司综合毛利率的拖累，预计何时可以基本消除？

您好，感谢对公司的关注。下游动力电池加速向极薄铜箔迭代，储能需求增长也带动相关订单放量，公司极薄锂电铜箔的出货占比正在稳步提升，储能相关订单规模持续增长。锂电铜箔板块盈利修复取决于行业加工费走势、极薄产品出货占比提升进度；铜扁线业务改善取决于成本管控、客户结构优化。

13. 除 HVLP 系列外，公司正在推进 IC 封装用载体铜箔的研发，向半导体上游材料延伸。请问载体铜箔/IC 封装基板用铜箔目前客户验证进度如何、预期量产时间和规划产能是多少？大功率基板用超厚铜箔等品类的客户导入情况如何？这些新品类能否在 2027 年前形成规模化收入，公司对新业务的投入强度与研发预算安排是怎样的？

您好，感谢对公司的关注。公司载体铜箔正在推进新产品的技术研发及产业化工作。

14. hvlp4 铜箔 Q3 会放量吗

您好，感谢对公司的关注，HVLP1-4 系列产品已实现批量供货。

15. 请问下半年在业绩说明会、机构反路演、海外路演方面有哪些具体安排？公司是否将市值管理纳入管理层考核指标，是否有推动纳入核心指数与相关 ETF 的安排？在信息沟通节奏上，

	是否会建立更常态化的月度/季度经营数据披露机制？ 您好，感谢对公司的关注。公司会按监管要求，加强与投资者交流。公司已被纳入创业板指、深证成指样本股及 MSCI 中国指数。目前公司信息披露以法定定期报告和临时公告为主，暂未考虑月度/季度经营数据披露机制。 16. 半年报显示公司高频高速 PCB 铜箔产量占 PCB 铜箔总量已经突破 50%，主要供给 AI 服务器覆铜板。请问 HVLP4 代当前客户认证与出货规模如何？下半年 HVLP 系列加工费是否有继续上调空间？HVLP5 代研发和客户送样预计什么时间落地？ 您好，感谢对公司的关注。公司 HVLP4 代铜箔已实现量产，尚处于产能爬坡阶段。公司 HVLP 铜箔定价综合考虑成本、市场供需及客户情况确定产品售价。 17. 当前 AI 服务器算力需求持续扩张，高端高频高速铜箔处于供不应求状态，能否介绍头部服务器覆铜板客户的订单锁定情况，以及下半年高端 PCB 铜箔的排产、出货量指引？ 您好，感谢对公司的关注。公司 HVLP 铜箔目前在手订单充足。 18. 公司正在推进 IC 封装载体铜箔研发，载体铜箔是 HBM、先进封装的关键材料，请问载体铜箔目前送样、客户验证进展，预计何时实现小批量供货，未来规划产能规模是多少？ 您好，感谢对公司的关注。公司载体铜箔正在推进新产品的技术研发及产业化工作。 19. 半年锂电铜箔毛利率修复至 3.77%，储能与动力电池需求回暖，请问锂电板块下半年订单、加工费走势，公司是否继续推进部分传统锂电产线转产高端 PCB 铜箔，产能结构调整计划如何？ 您好，感谢对公司的关注。公司坚持 PCB 铜箔+锂电池铜箔“双轮”驱动发展模式，积极推进先进工艺研发和产品升级工作，不断优化产品结构。 20. 公司产品采用“铜价加工费”模式，铜价波动由加工费
--	---

	对冲。当前高端铜箔供需紧张，请问公司加工费的调价机制，下半年高端 PCB 铜箔加工费能否维持上行趋势，对全年毛利率带来多大弹性？ 您好，感谢对公司的关注。公司铜箔定价综合考虑成本、市场供需及客户情况确定产品售价。 21. 董秘，您好！结合 2026 半年报，公司 HVLP 高端 PCB 铜箔研发迭代进展如何？HVLP 各代产品送样、客户验证与批量供货情况如何？后续高端铜箔研发立项规划，以及研发投入安排能否介绍？ 您好，感谢对公司的关注，HVLP1-4 已批量供货并已通过全系列认证，HVLP5 已突破关键性能指标。载体铜箔正在推进新产品的技术研发及产业化工作。 22. 公司总产能 8 万吨/年，上半年产能利用率达到 90.6%。请问未来 2 年资本开支规划，是否新增 HVLP/RTF 高端铜箔产能，新增产能投产节奏、客户配套如何安排？ 您好，感谢对公司的关注。公司未来资本开支将围绕产品结构优化，审慎控制资本开支规模与节奏。 23. 董秘，您好！GB38031-2025 动力电池安全标准自 2026 年 7 月 1 日实施，锂电铜箔面临升级需求。请问公司适配新标准的高端锂电铜箔布局、技术储备及下游送样情况如何？ 您好，感谢对公司的关注，公司将紧跟市场和客户的最新需求。 24. 半年报提到公司产品已进入英伟达、谷歌、AWS 等高端服务器供应链。作为极少数通过英伟达服务器 PCB 供应链审核的内资厂商，公司在认证过程中克服了哪些关键工艺壁垒？这一认证资质是否为公司带来了排他性的订单锁定或加工费溢价优势？” 您好，感谢对公司的关注。公司 PCB 铜箔下游客户主要是覆铜板厂商和印制线路板厂商。公司在核心制造技术领域突破了“极低轮廓与高剥离强度相互制约”等技术瓶颈。 25. 从行业竞争格局看，国内多家企业布局 HVLP 高速铜箔，
--	--

公司 RTF 铜箔内资领先。请问公司在高端铜箔的技术壁垒、客户认证壁垒有哪些，如何持续维持在 AI 服务器 PCB 铜箔领域的竞争优势？

您好，感谢对公司的关注。高频高速铜箔生产难度主要体现在设备精密程度要求高，订货周期长、生产工艺复杂，精度要求高、客户认证门槛高，认证周期长等多方面。

26. 高附加值铜箔业务能否成为未来 2-3 年核心增长第二曲线？

您好，感谢对公司的关注。高附加值高端铜箔是公司未来 2-3 年重点布局的战略业务方向。

27. 董秘，您好！参考 2026 半年报，公司后续降本增效将从哪些环节落地？在原材料采购管控、能耗优化、产线良率提升、费用管控方面，有哪些具体落地举措？

您好，感谢对公司的关注，公司将在保证产品品质和提升产品良率的前提下，有计划稳步地开展降本增效。

28. 公司高频高速铜箔具备出海规划，请问海外覆铜板、服务器客户拓展进度，海外订单预计什么时候贡献营收，海外市场毛利率水平是否高于国内？

您好，感谢对公司的关注。公司自主研发的高端 HVLP 铜箔产品在多元环境中的持续提升，实现规模化出口。

29. 公司半年报显示传统铜箔盈利承压，市场最关注AI 算力服务器、HBM 配套用超薄铜箔**业务，请问当前该类高附加值产品的在手订单、客户验证进展，下半年能否实现营收和毛利的明显放量，预计该业务占全年营收比重可以达到多少？**

您好，感谢对公司的关注。公司 HVLP 铜箔目前在手订单充足。

30. 对比同行，公司铜箔毛利率阶段性偏弱，请问核心制约因素是原材料、产能稼动率还是产品结构？管理层判断毛利率拐点将在哪个季度出现，有无明确的改善量化目标？

您好，感谢对公司的关注。公司铜箔采用“铜价+加工费”

	定价模式，铜价的波动会对报表层面毛利率产生扰动，公司盈利核心来源于加工费收入。 31. 市场担忧 AI 铜箔赛道存在技术迭代风险，请问公司在 HBM 载板、高速 PCB 用极薄铜箔上的技术壁垒，下一代产品研发进度，能否跟上算力芯片迭代节奏，会不会出现技术落后的风险？ 您好，感谢对公司的关注。公司高度重视技术创新领域，并与客户保持紧密技术交流。 32. 董秘，您好！对标三井、古河、嘉元、德福等同业，公司 HVLP 高端铜箔在产品指标、客户结构上的核心竞争优势？如何持续推进高端铜箔的国产替代进程？ 您好，感谢对公司的关注，公司前瞻性布局高端铜箔赛道，已实现 HVLP1-4 系列产品的批量供货及认证。当前全球 HVLP 高端铜箔市场，日系厂商凭借长期工艺沉淀、成熟供应链体系，占据较高有效供给份额，国产替代是循序渐进的过程，并非一次性替代。 33. 请问甘董：公司三季度的高端电子铜箔加工费相比较上一个季度有提价吗 您好，感谢对公司的关注。请关注公司三季度报告。 34. 上半年行业下游 PCB 分化明显，消费电子偏弱、算力板块高景气。请问公司产品结构拆分，算力相关铜箔、储能铜箔、消费电子铜箔各自营收占比，下半年下游各板块需求展望？ 您好，感谢对公司的关注。2026 年上半年公司实现 PCB 铜箔收入 25.07 亿元，锂电池铜箔收入 13.74 亿元。2026 年上半年，铜箔行业景气度持续回升，锂电铜箔板块整体回暖，高端 PCB 铜箔呈现供不应求态势，行业实现量价齐升。 35. 公司新建高端铜箔产能陆续投产，市场担忧行业新增产能集中释放引发价格战。请问公司高端产线的客户锁单情况，哪些客户已经签订长协订单，如何规避同质化低价竞争？ 您好，感谢对公司的关注。高端铜箔产能遵循认证先行的原
--	--

则，目前壁垒较高，公司高频高速铜箔等高附加值订单供不应求。

36. 请问公司目前 HVLP4 产品良率是什么水平？目前受限部分在哪里？后续计划如何提高？

您好，感谢对公司的关注，HVLP4 仍处于持续爬坡阶段，还有工艺优化与良率提升空间。

37. 2026 年上半年经营活动现金流净额为-2.85 亿元，已是连续四期半年报为负，净现比-132.65%，与 2.15 亿元的净利润形成明显背离。请问管理层如何拆解现金流为负的结构原因（应收账款周转、存货占用、票据结算比例）？公司对铜价的套期保值覆盖比例大致是多少，能否对冲存货跌价风险？以及最关键的——经营现金流由负转正的时间窗口和具体路径是什么？

您好，感谢对公司的关注。公司销售回款的银行承兑汇票存在贴现、背书转让，部分票据贴现不满足终止确认条件，需计入筹资活动现金流入，且票据背书回款未体现在经营现金流中，致使经营现金流净额与净利润出现差异。

38. “半年报显示，公司高频高速基板用铜箔产量占 PCB 铜箔总产量的比例已突破 50%，且呈现供不应求态势。在当前 AI 服务器、高速网络等高端应用持续拉动需求的背景下，公司在高频高速铜箔领域的产能布局和技术壁垒，将如何进一步转化为下半年的业绩增量？”

您好，感谢对公司的关注。公司将抢抓行业发展机遇，持续扩大高附加值产品市场占比，适时上调产品加工费，有效增厚盈利水平，实现企业价值提升。

39. “当前铜箔行业有效产能的实际供应缺口预计将在 2026 至 2028 年持续存在。公司近期表示暂无新增扩产计划，在行业整体回暖、同行积极扩产的环境下，公司将如何通过现有产能优化和产品结构升级，来把握本轮行业景气周期带来的市场机遇？”

您好，感谢对公司的关注，公司将根据市场需求、技术迭代及自身战略，稳步推进新产品研发，持续优化产能结构，满足客

户需求。

40. “上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-2.85 亿元，但同比已改善 37.74%。同时，公司在业绩大幅增长的背景下推出了每 10 股派现 0.6 元的中期分红方案。请问公司下半年在改善经营性现金流方面有哪些具体措施？未来是否会考虑通过提高分红比例或回购等方式，进一步回馈投资者？”

您好，感谢对公司的关注。公司销售回款的银行承兑汇票存在贴现、背书转让，部分票据贴现不满足终止确认条件，需计入筹资活动现金流入，且票据背书回款未体现在经营现金流中，致使经营现金流净额与净利润出现差异。

41. “目前 HVLP4 代铜箔正在多家 CCL 厂家认证中，而 HVLP5 代已完成中试。请问公司能否披露 HVLP4 代在核心 CCL 客户（如台光电子、生益科技）处的认证进展？认证通过后，预计何时能实现从‘小批量试供’到‘批量放量’的跨越？”

您好，感谢对公司的关注。公司 HVLP4 代铜箔已实现量产。

42. “高端铜箔的客户认证周期通常需要 12-18 个月。在当前同业纷纷扩产高端产能的背景下，公司已与头部客户建立的深度认证合作关系，是否构成了实质性的准入壁垒？未来 1-2 年内，是否有新的国际头部客户认证计划，以进一步扩大高端产品在全球供应链中的份额？”

您好，感谢对公司的关注。高端铜箔产能遵循认证先行的原则，目前壁垒较高，公司高频高速铜箔等高附加值订单供不应求。

43. 董事长，您好！载体可剥离铜箔是 IC 封装基板核心材料，请问公司该产品当前研发、送样及客户验证进展？是否有配套产线规划，是否纳入池州项目或后续扩产计划？

您好，感谢对公司的关注。公司载体铜箔正在推进新产品的技术研发及产业化工作。

44. 董事长，您好！公司是否计划通过定向增发等股本融资方式，新建高端铜箔产线？如有，主要考量因素有哪些；若无，后续高端铜箔扩产项目的资金来源如何规划？

	您好，感谢对公司的关注。公司如有进一步扩产计划，将会严格按照监管要求进行信息披露。 45. 董事长，您好！公司是否考虑通过并购重组打通下游产业链，增强经营抗风险能力？若有相关思路，优先关注哪些方向；若无，公司保障产业链供应链安全的策略是什么？ 您好，感谢对公司的关注。公司如有进一步计划，将会严格按照监管要求进行信息披露。 46. “上半年公司 PCB 铜箔业务营收同比增长 47.16%，毛利率达到 11.60%，成为核心利润来源。随着高端电子铜箔国产替代进程加速，公司自主研发的系列高端产品已通过国际头部客户认证并批量供货。请问公司在高端产品持续放量、加工费上调的背景下，对未来整体毛利率的修复空间有何预期？” 您好，感谢对公司的关注。伴随高端电子铜箔国产替代持续推进，公司在高附加值产品出货占比稳步提升。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 18 日